

## Willkommen bei O-Leading

Wir sind professioneller Leiterplattenhersteller mit mehr als zehn Jahren Erfahrung. Einzelne Produktreihe, doppelseitige, mehrschichtige Leiterplatte, flexible Leiterplatte und MCPCB. Wir bieten schnellen Prototypservice - S / S in 24 Stunden, 4-8 Schichten in 48-96 Stunden Produktionszeit.

[\(LED-Platine Leiterplatte China\)](#)

KUPFERPLATTENLÖCHER MINDEST .025 AVG, .020 MIN. LÖCHER DÜRFEN NICHT GESTROMT WERDEN

Packen Sie mit farbloser, transparenter Luftpolsterfolie, 25 Stck./Tasche, Trockenmittel in die Flanke, setzen Sie die Feuchtigkeitsanzeige auf die Oberseite

BITTE KLICKEN SIE DIESE FÜR WEITERE INFORMATIONEN: [Hersteller von Leiterplatten](#)

## Produktbeschreibung

PCB P / N	Halogenfreie Rohstoffplatine mit S1550 TG 150
Schichtanzahl	2L
Material	FR-4 TG150 halogenfrei
Board thk	1,60 mm
kupfer thk	1 / 1oz
Kleinste Lochgröße	0,50 mm
Anzahl der Löcher (Stück)	29
Zeile w / s	10/8 mil
Impedanzkontrolle J / N (Tol%)	N
Oberflächenveredelung	ENIG Au: 0,05-0,10UM
Lötmaske-Siebdruck	Mattgrün / N / A
Einzelplatinengröße	Dim X (mm): 21,5; Dim Y (mm): 60,3
Panelisierung	Dim X (mm): 108, Dim Y (mm): 138,1, Anzahl der USV: 8
Besonderheit: abziehbare Maske	N
Routing / Lochen	CNC

•





[www.o-leading.com](http://www.o-leading.com)

- 
- 
- [china Starre-flexible Leiterplattenhersteller](#)

Unser Team





Zertifizierungen



201726 201VZL430354 - Wiring, Printed - Component



ZPMV2.E490354  
Wiring, Printed - Component

For enhanced search functionality, please visit UL's [QPL Family of Databases](#).  
Click on a product designation for complete information.

Page Bottom

Wiring, Printed - Component

See General Information for Wiring, Printed - Components

O-LEADING SUPPLY CHAIN CO LIMITED

E490354

Fortune Building, Nanheng West Road  
Room 1313  
Huizhou, Guangdong 516211, CHINA

	Cond Width			SS/ DS/	Area Diam	Solder		Temp		Flame	RoHS	C
	Min	Max	Min			Max	Class	DSR				
Min	Edge	Thk	DS/	Thk	DS/	Temp	Flame	UL796	T			
Typ	max(in)	mm(in)	mil(mm)	DSO	max(in)	C	sec	C	Class	DSR	I	
<b>Multi-layer (mass laminate) printed wiring boards.</b>												
<b>O-LEADING-401</b>												
	0.2 (0.004)	0.3 (0.012)	34 (0.34)	D6	12.7 (0.5)	260	10	130	V-0	-	-	
<b>O-LEADING-407</b>												
	0.08 (0.003)	0.2 (0.008)	17 (0.67)	D5	9.2 (0.4)	260	10	170	V-0	NI	-	
<b>Multi-layer printed wiring boards.</b>												
<b>O-LEADING-408</b>												
	0.125 (0.005)	0.125 (0.005)	12 (0.47) min:1.25	D6	50.8 (2.0)	260	20	130	V-0	NI	*	
<b>Single layer printed wiring boards.</b>												
<b>O-LEADING-002</b>												
	0.76 (0.015)	1.14 (0.045)	34 (1.34)	S5	19.1 (0.8)	260	10	105	V-0	NI	-	
<b>O-LEADING-003</b>												
	0.38 (0.015)	1.14 (0.045)	34 (1.34)	S5	19.1 (0.8)	260	10	130	V-0	▲	-	
<b>O-LEADING-033</b>												
	0.15 (0.006)	0.3 (0.012)	34 (1.34)	S5	25.4 (1.0)	260	10	120	V-0	NI	-	
<b>O-LEADING-205</b>												
	0.1 (0.004)	0.3 (0.012)	34 (1.34)	D6	69.6 (2.7)	260	10	130	V-0	NI	-	
<b>O-LEADING-206</b>												
	0.15 (0.006)	0.33 (0.013)	17 (0.67)	D5	69.6 (2.7)	260	10	130	V-0	NI	-	

\* - CTI marking is optional and may be marked on the printed wiring board.

Marking: Company name or file number and type designation. May be followed by a suffix to denote factory identification or burning test classification.  
Last updated on 2017-01-27

Questions? [Print this page](#) [Terms of Use](#) [Page Top](#)

http://www.ul.com/qpl/qpl.html?search=ZPMV2.E490354&searchType=Wiring,Printed-Component&id=10



Test Report

No. CANEC1805164701

Date: 03 Apr 2018

Page 2 of 8

Test Results:

Test Part Description:

Specimen No. **SGS Sample ID** **Description**  
SN1 CAN18-051647.001 Green "PCB"

Remarks:

- (1) 1 mg/kg = 1 ppm = 0.0001%
- (2) MDL = Method Detection Limit
- (3) ND = Not Detected (< MDL)
- (4) "-" = Not Regulated

RoHS Directive (EU) 2015/863 amending Annex II to Directive 2011/65/EU

Test Method: With reference to IEC 62321-4:2014+A1:2017, IEC62321-5:2013, IEC62321-7-2:2017, IEC 62321-6:2015 and IEC62321-8:2017, analyzed by ICP-OES, UV-Vis and GC-MS.

Test Item(s)	Limit	Unit	MDL	Det
Cadmium (Cd)	100	mg/kg	2	ND
Lead (Pb)	1,000	mg/kg	2	9
Mercury (Hg)	1,000	mg/kg	2	ND
Hexavalent Chromium (CrVI)	1,000	mg/kg	8	ND
Sum of PBBs	1,000	mg/kg	-	ND
Monobromobiphenyl	-	mg/kg	5	ND
Dibromobiphenyl	-	mg/kg	5	ND
Tribromobiphenyl	-	mg/kg	5	ND
Tetrabromobiphenyl	-	mg/kg	5	ND
Pentabromobiphenyl	-	mg/kg	5	ND
Hexabromobiphenyl	-	mg/kg	5	ND
Heptabromobiphenyl	-	mg/kg	5	ND
Octabromobiphenyl	-	mg/kg	5	ND
Nonabromobiphenyl	-	mg/kg	5	ND
Decabromobiphenyl	-	mg/kg	5	ND
Sum of PBDEs	1,000	mg/kg	-	ND
Monobromodiphenyl ether	-	mg/kg	5	ND
Dibromodiphenyl ether	-	mg/kg	5	ND
Tribromodiphenyl ether	-	mg/kg	5	ND
Tetrabromodiphenyl ether	-	mg/kg	5	ND
Pentabromodiphenyl ether	-	mg/kg	5	ND



SGS is pleased to announce the launch of its new RoHS testing service. This service is designed to help manufacturers and suppliers ensure compliance with the RoHS Directive (EU) 2011/65/EU and its amendments. The service covers the testing of various types of printed circuit boards (PCBs) and components. For more information, please contact your local SGS office or visit our website at [www.sgsgroup.com](http://www.sgsgroup.com).

Member of the SGS Group (SGL SA)

# Verpackung & Lieferung

Verpackungsinformationen	16 Jahre professioneller OEM Leiterplattenhersteller
Lieferungsdetails	7-12days



## FAQ

1. Wie sichert O-Leading Qualität?

Unser hoher Qualitätsstandard wird mit folgendem erreicht.

1. Der Prozess wird streng nach ISO 9001: 2008 Standards kontrolliert.
2. Umfassender Einsatz von Software zur Verwaltung des Produktionsprozesses
3. Stand der Technik Testgeräte und Werkzeuge. Z.B. Flying Probe, Röntgeninspektion, AOI (Automated Optical Inspector) und ICT (In-Circuit-Test).
4. engagiertes qualitätssicherungsteam mit fehlerfallanalyseprozess
5. Kontinuierliche Schulung und Schulung des Personals

2. Wie hält O-Leading Ihren Preis wettbewerbsfähig?

Im letzten Jahrzehnt hatten sich die Preise vieler Rohstoffe (z. B. Kupfer, Chemikalien) verdoppelt, verdreifacht oder vervierfacht. Chinesische Währung RMB hatte 31% gegenüber dem US-Dollar aufgewertet; Und unsere Arbeitskosten sind auch deutlich gestiegen. O-Leading hat jedoch unsere Preise stabil gehalten. Dies trägt ganz zu unseren Innovationen bei der Kostenreduzierung, der Vermeidung von Verschwendung und der Verbesserung der Effizienz bei. Unsere Preise sind in der Branche auf dem gleichen Qualitätsniveau sehr wettbewerbsfähig.

Wir glauben an eine Win-Win-Partnerschaft mit unseren Kunden. Unsere Partnerschaft ist für beide Seiten von Vorteil, wenn wir Ihnen einen Kosten- und Qualitätsvorteil bieten können.

3. Welche Arten von Boards können von O-Leading verarbeitet werden?

Gängige FR4-, High-TG- und halogenfreie Platinen, Rogers, Arlon, Telfon, Platinen auf Aluminium- / Kupferbasis, PI usw.

4. Welche Daten werden für die Leiterplattenproduktion benötigt?

Es ist am besten, Daten im Gerber 274-X-Format bereitzustellen. Darüber hinaus können Cam350, CAD, Protel 99se, PADS, DXP und Eagle verarbeitet werden.

5. Was ist der typische Prozessablauf für mehrschichtige Leiterplatten?

Materialschneiden → Innerer Trockenfilm → Inneres Ätzen → Inneres AOI → Multi-Bond → Schichtstapel Pressen → Bohren → PTH → Plattieren → Äußerer Trockenfilm → Musterplattieren → Äußeres Ätzen → Äußeres AOI → Lötmaske → Bauteilmarkierung → Oberflächenfinish → Routing → E / T → Sichtprüfung.